

2006年3月2日

プリント配線板用銅張積層板等の価格改定を実施

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：長瀬寧次、資本金：153億円)は、プリント配線板用の銅張積層板、プリプレグ、シールド板(内層回路入り銅張積層板)について、2006年4月1日納入分より価格改定を実施することを決定しました。

銅張積層板は、ガラス繊維を織り上げたガラスクロスにエポキシ等の樹脂を含浸させ、その両面に銅箔を張り付けたもので、プリント配線板の基板材料です。一方、プリプレグはガラスクロスに樹脂を含浸させたもので、プリント配線板を多層化する際の接着材料です。シールド板は銅張積層板の一種で、予め内層のみ回路加工を施した製品です。

銅張積層板、プリプレグ、シールド板の主要原材料である銅箔、ガラスクロス及び樹脂・溶剤の価格は一昨年来高騰しており、当社では昨年9月に銅張積層板、プリプレグ、シールド板の価格改定を実施しましたが、今年に入って各原材料が一段と急騰しております。

当社では、主要原材料の価格高騰に対応するため、生産性向上等の原価低減に鋭意取り組んでまいりましたが、自助努力には限界があるほか、原材料を安定的に確保するためには原材料メーカーの値上げ要請を受け入れることが必要と判断し、以下のとおり原材料価格の上昇分を製品価格に一部転嫁させていただくことと致しました。

1．価格改定製品と現行価格に対する改定幅

(1)銅張積層板	16%アップ
(2)シールド板(内層回路入り銅張積層板)	10%アップ
(3)プリプレグ	10%アップ

2．実施時期

2006年4月1日納入分より

以上

(報道関係お問い合わせ先)

日立化成工業株式会社 コーポレート戦略室(広報・IR) 長谷川 TEL 03-5381-2371

(製品に関するお問い合わせ先)

日立化成工業株式会社 配線板材料事業部 事業企画グループ 舟井 TEL 03-5446-9273